

LMP シンポジウム 2025

レーザー加工技術の基礎・応用と最新動向

開催日：2025年3月4日（火）～3月5日（水）

開催方式：ハイブリッド方式

（会場開催：北九州国際会議場 2F 国際会議室／Web 開催：Zoom ウェビナー）

主 催

一般社団法人 日本溶接協会

企 画

レーザー加工技術研究委員会（LMP 委員会）
(Laser Materials Processing Committee)

後 援

- ◆一般社団法人溶接学会
- ◆一般社団法人日本鉄鋼協会
- ◆一般社団法人軽金属溶接協会
- ◆一般社団法人レーザー学会
- ◆レーザー協会
- ◆中部レーザー応用技術研究会
- ◆一般社団法人 日本機械学会
- ◆公益社団法人 自動車技術会
- ◆福岡県工業技術センター
- ◆一般社団法人レーザー加工学会
- ◆一般社団法人スマートプロセス学会
- ◆一般社団法人日本チタン協会
- ◆公益財団法人日本金属学会
- ◆ステンレス協会
- ◆産報出版株式会社
- ◆公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- ◆一般社団法人 日本機械学会 中国四国支部
- ◆一般社団法人溶接学会 九州支部

（順不同、依頼中含む）

〔 開 催 趣 旨 〕

レーザー加工は産業界における適用が拡大し、レーザー発振器のほかレーザー加工用光学系、自動化システム、加工現象観察・診断装置などの周辺機器とその利用技術は日進月歩で開発が進められています。適用技術分野についても溶接・切断からマイクロ加工、3Dプリンタに代表される積層・部品直接造形など拡大の一途をたどり、今後も新たな分野への進展が期待されます。日本溶接協会 レーザ加工技術研究委員会（LMP 委員会）では、レーザー加工技術の普及と最新技術情報の周知を目的として、2001年より毎年その時々の最新レーザー装置、加工技術、業界の動向などを紹介するレーザー加工シンポジウムを開催して参りました。今年度は、北九州国際会議場での現地開催とWEB会議のハイブリッド方式での2日間の開催となります。最近注目されている各種レーザー加工装置、プロセスおよび応用例など、我が国におけるレーザー加工技術のトレンドを総覧いただける講演と、恒例の現地見学を実施できる運びとなり、ニューノーマルなシンポジウムを皆様にご紹介させていただく運びとなりました。

最近注目されているレーザー加工技術を総覧いただくことに加えて、レーザー加工をこれから検討しようとする方々向けの基礎知識習得のための講演も選出しております。

是非この貴重な機会をご利用いただき、皆様の今後のレーザー溶接・レーザー加工の導入検討あるいは更なる新技術開発を行う一助としていただければと思います、ここにご案内申し上げます。

■第1日目：3月4日（火）

10:30～10:40	開会挨拶、シンポジウム聴講上のご注意	レーザ加工技術研究委員会 委員長 山本 元道 氏（広島大学）
セッション1 【レーザ加工の基礎】		司会：佐藤雄二（大阪大学）
10:40～11:20	レーザ溶接の基礎と最新動向	大阪大学名誉教授／(株)ナ・デックス 片山 聖二 氏
11:20～12:00	半導体レーザとホットワイヤ法とを組み合わせた溶接・接合技術	広島大学 山本 元道 氏
12:00～13:00	昼食休憩（60分） ★現地参加の方にはお弁当をご用意します	
セッション2 【自動車/EVを実現するレーザ加工】		司会：佐藤雄二（大阪大学）
13:00～13:40	E-mobility時代を担うレーザ溶接技術の進化とモノづくりイノベーション	(株)デンソー 白井 秀彰 氏
13:40～14:20	TWB 構造ラダーフレームの接合に適したレーザ・アークハイブリッド溶接システムの開発	(株)ダイヘン 恵良 哲生 氏
14:20～15:00	青色レーザと材料解析機器を活用した高品質レーザ加工	(株)島津製作所 宇野 進吾 氏
15:00～15:20	休憩（20分）	
セッション3 【レーザ加工が切り拓く半導体産業】		司会：中川龍幸（パナソニックコネク）
15:20～16:00	レーザ加工技術と半導体分野への応用展開	東レエンジニアリング(株) 梅田 英知 氏
16:00～16:40	半導体露光用エキシマレーザを用いた難加工材料のレーザ加工応用	ギガフォトン(株) 三浦 泰祐 氏
16:40～17:20	パワー半導体デバイス創成に向けた青色レーザマルチビーム LMD 法による窒化アルミニウムへの銅皮膜形成技術	大阪大学 接合科学研究所 徳本 潤平 氏

■第2日目：3月5日（水）

セッション4 【大出力レーザ加工の最新動向】		司会：坪田秀峰（三菱重工業）
9:00～9:40	造船向け 20kW ファイバーレーザ開先切断機の開発	日酸 TANAKA(株) 黒澤 徳弘 氏
9:40～10:20	レーザ・アークハイブリッド溶接による厚板接合の品質改善に関する諸検討	九州大学 後藤 浩二 氏
10:20～11:00	ワイヤ・レーザ金属 3D プリンタの最新造形事例	三菱電機(株) 森田 大嗣 氏
11:00～11:10	休憩（10分）	
セッション5 【レーザ微細加工技術が切り開く新たなものづくり】		司会：佐藤雄二（大阪大学）
11:10～11:50	レーザ精密微細加工への取り組み	岡山大学 岡本 康寛 氏
11:50～12:30	経済安全保障重要技術育成プログラムにおける高出力シングルモードファイバーレーザの開発	川崎重工業(株) 西田 太一 氏
12:30～12:35	閉会挨拶および見学会説明	レーザ加工技術研究委員会 副委員長 佐藤 雄二 氏（大阪大学）
12:35～13:05	昼食休憩（30分） ★現地参加の方にはお弁当をご用意します	
見学会 【見学ルート① 株式会社安川電機本社工場】【見学ルート② 福岡県工業技術センター】		
13:10～17:30	見学ルート（予定） ※2班に分かれてバス乗車し①②入れ替えの見学となります。 ※人数状況により見学ルートがいずれか選択式となる可能性があります。（100名上限） 13:10 出発：北九州国際会議場（チャーターバス移動） →①株式会社安川電機 安川電機みらい館 / 歴史館 →②福岡県工業技術センター機械電子研究所 →17時半頃 小倉駅にて解散	

【ご留意事項】講師およびスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

最新情報は LMP 委員会 Web サイト (<https://www.jwes.or.jp/committees/laser/symposiums/>) にてご確認ください。

〔 開催要領 〕

1. 日 時

2025年3月4日（火） （第1日目） 10:30～17:20

2025年3月5日（水） （第2日目） 09:00～12:35 （見学会） 13:10～17:30

2. 定 員

会場 100名（見学者定員：100名 希望者先着順）、WEB 100名

見学ルート：①株式会社安川電機みらい館 / 歴史館、②福岡県工業技術センター機械電子研究所

3. 参加料 （1名分、テキスト代（PDF）・消費税を含む）

参加区分	協会会員※1	後援団体・指定機関会員※2	非会員
見学会参加※3	25,000円	28,000円	30,000円
見学会不参加 WEB参加	20,000円	23,000円	25,000円

・いずれか1日のみ参加の場合も上記料金となります。

※1 日本溶接協会団体会員会社（<https://www.jwes.or.jp/about/membership/> 参照）にご所属の方。

※2 本シンポジウム後援団体（パンフレット1ページ目に記載）会員の方、または日本溶接協会指定機関会員企業の方。

※3 会場参加者の方のみ選択可能。

4. 申込期限

2025年2月18日（火） （ただし、定員に達し次第〆切）

5. 申込要領

(1) お申込みは以下の当協会 講習会・シンポジウムオンライン受付ページよりお願い致します。

➤ <https://www-it.jwes.or.jp/seminar/>（右側記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます）

※当協会ホームページ「お知らせ・募集」（<http://www.jwes.or.jp/>）にも案内を掲示しております。



(2) 入力いただいた個人情報、法律に則った当協会の方針に従い管理します。詳細は「一般社団法人日本溶接協会 個人情報保護方針」（<http://www.jwes.or.jp/privacy.html#info>）をご参照ください。

(3) 「会場参加」でお申込みの方で、1日目・2日目のどちらかWEB参加を希望する方は申込時「摘要欄」にてお知らせください。WEB参加の事前登録案内をメールでお送りいたします。

(4) 当協会側でお申込み確認後に送信する受講確定メールに「受講番号」が記載されております。当日シンポジウムのZoom会議室に入室する際、お名前欄に受講番号を入力いただきますので、当日までメールを保管くださいますようお願い申し上げます。

(5) 受講確定メールをご確認の上、参加料を以下の口座へお振込みください。

お振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通 No.0146921（一社）日本溶接協会 シヤニホソウケツキョウカイ

※振込手数料は貴社にてご負担ください。

※領収書をご希望の方：申込締切後1週間程度を目途に、JWESトップページ（電子領収書）からダウンロードできるようになります。 <http://www.jwes.or.jp/>

(6) お振込後の参加費は返金致しかねます。ご欠席の場合は、代理出席をお願い致します。

(7) 開催3日前までにメールにてPDFテキストのご案内をお送りします。未着の場合は事務局までご連絡ください。

6. 事務局（問い合わせ先）

一般社団法人日本溶接協会 業務部 大宮 Mail：kanae_omiya@jwes.or.jp

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 TEL：03-5823-6324 FAX：03-5823-5244

7. 開催方針

・会場（溶接会館）とWeb（Zoomウェビナー）のハイブリット形式での開催といたします。

・取材許可を得た関係者以外によるシンポジウム内容の写真およびビデオ撮影は固くお断り致します。

・最新情報は当協会 レーザ加工技術研究（LMP）委員会ホームページ（<https://www.jwes.or.jp/committees/laser/>）にて随時ご案内します。ご確認の程宜しくようお願い申し上げます。

〔Web 参加者の皆様へ〕

以下の要領にてシンポジウムをオンライン開催いたしますので、お申込み前に十分ご確認ください。

WEB 参加をお申込みいただいた方に、開催 10 日前を目途に Zoom ウェビナー事前登録のご案内メールをお送りします。また、聴講に必要な Zoom の操作、聴講に際しての注意事項などの案内も併せて送付する予定です。

参加料は 1 名あたりの価格となりますので、複数人で視聴する際は視聴人数分のお申込みをお願いいたします。

1. 利用システム

Zoom ウェビナー (<https://zoom.us/jp-jp/webinar.html>)

2. 受講者側で準備いただくもの

- ・インターネット環境
- ・上記に接続されている PC、スマートフォン、タブレット

※受講者側ではカメラを使用しませんので、準備の必要はございません。質疑応答では各自マイクを使用して発言いただきますので、マイクは必要に応じて事前にご準備ください。聴講、発言時の音声品質の確保のためには、ヘッドセット、イヤホンマイクの使用を推奨いたします。

- ・Zoom アプリ

※Zoom はブラウザでも使用できますが、通信品質確保のためアプリでの参加を推奨いたします。予め、聴講に使用される PC に Zoom アプリをインストールしておいていただければと存じます。

※Zoom 使用のためのシステム要件は以下を参照ください。

<https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023>

3. 禁止事項

- ・申込者ご本人以外も自由に閲覧できるような環境（例：仕切りのないオープンスペース、テレビやスピーカーでの映像・音声放送）での受講をご遠慮ください。
- ・シンポジウム配信画面の記録（撮影・録音・録画・スクリーンショットの取得その他一切の手段による）および講演内容の無断転用・無断転載を禁止します。

4. Zoom ウェビナーへの参加方法

・Zoom ウェビナーの会議室入室に必要な情報および画面操作案内は、お申込みいただいた方へ開催 10 日前を目途にメールで配信します。

〔会場参加者の皆様へ〕

【注意事項】

- ・開場および受付開始時間は、両日ともシンポジウム 開始時間の 30 分前とします。
- ・現地にてご参加いただく方には昼食（無料）をご用意します。（申込時要予約／協会会員・後援団体会員・非会員 共通）スケジュールの都合上、2日目の昼食休憩時間が短くなっております。何卒ご了承ください。
- ・ご宿泊予約や会場までの交通機関のチケットは各自でお手配いただきますようお願い致します。
- ・講演資料（テキスト）は PDF での事前配布のみとします。必要な方は各自印刷をしてご持参ください。
- ・当日は受付の際に、受講確定メールに記載されている【受講番号】で出席確認いたします。メール画面の印刷またはスマートフォンの画面をご提示下さい。
- ・本シンポジウムは、当協会の最新の「新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」に従います。マスク着用（各自ご用意）は任意といたします。
- ・駐車場は来場者用有料駐車場をご利用ください。

北九州国際会議場 ご案内図

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目9-30

JR小倉駅から徒歩5分

西日本総合展示場・北九州国際会議場 JR小倉駅からのアクセスマップ

The image is a composite of a map and eight numbered photographs (1-8) with red arrows indicating the route from JR Kitakyushu Station to the West Japan General Exhibition Hall and Kitakyushu International Conference Center.

1 JR小倉駅の新幹線口(北口)方面よりペDESTリアンデッキを進む

2 動く歩道に乗り終点まで進む

3 動く歩道の終点から右折する

4 西日本総合展示場新館・AIMビル入口から入る

5 左手側が新館、右手側がAIM。本館と国際会議場は突き当たりの出口まで直進

6 自動ドアを出て右手にあるエスカレータを下りる

7 エスカレータを下りて正面が本館。国際会議場は右折

8 正面の黄色い建物が国際会議場

◆アクセス詳細・駐車場のご案内は下記サイトからご確認ください。

【公益財団法人北九州コンベンション協会 WEBサイト】

<https://hello-kitakyushu.or.jp/access/>

LMP シンポジウム 2025
レーザー加工技術の基礎・応用と最新動向 見学会のご案内

【見学先①】株式会社安川電機 みらい館

所在地：〒806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1

【見学先②】福岡県工業技術センター 機械電子研究所

所在地：〒807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松3丁目6-1

【見学会にあたっての留意事項】

- 見学内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 見学の所要時間についても、当日の状況により若干の時間調整があることをご了承ください。
- 当日の交通状況により、見学時間および解散時間が遅れることがありますので、ご了承ください。
- グループ分けについては、参加各位のご希望を承れませんので、ご了承ください。（シンポジウム当日受付時にグループ分けをお知らせいたします）
- 見学コース途中での退席はご遠慮ください。
- マスク着用（各自ご用意）は任意といたします。

以上